

Title (en)
Sealing device, connector and method for manufacturing the same

Title (de)
Dichtungsvorrichtung, Verbinder und Herstellungsverfahren

Title (fr)
Dispositif d'étanchéité, connecteur et procédé de fabrication

Publication
EP 2741375 A1 20140611 (DE)

Application
EP 13005315 A 20131111

Priority
DE 102012024072 A 20121207

Abstract (en)
The device (7) has a stretchable pressure-sensitive switching element (19) arranged on a jacket surface of a sealing device main portion for covering a cable through-opening (11) to a fluid reservoir (13). A fluid is flowed through a fluid channel (15) along a cable feed-through direction (D) to the fluid reservoir. The stretchable pressure-sensitive switching element is made of elastic and located by pressurizing the fluid reservoir with the fluid of predetermined pressure to enlarge diameter of the sealing device main portion in a region of the switching element. Independent claims are also included for the following: (1) a connector (2) a method for manufacturing a connector.

Abstract (de)
Ein Aspekt betrifft eine Dichtungsvorrichtung, insbesondere für einen Verbinder, umfassend: - Eine Kabeldurchführöffnung, durch welche ein Kabel entlang einer Kabeldurchführrichtung D durchführbar oder durchgeführt ist, - einen Dichtbereich, der mit einem komplementären Dichtbereich eines Verbinders kontaktierbar ist, - zumindest ein dehnbares Haftvermittlungselement, welches an der Mantelfläche der Dichtungsvorrichtung angeordnet ist und welches eine Öffnung zu einem Fluidreservoir abdeckt, - zumindest einen Fluidkanal, durch welchen ein Fluid entlang der Kabeldurchführrichtung D zu dem Fluidreservoir fließen kann, wobei das Haftvermittlungselement durch das Beaufschlagen des Fluidreservoirs mit einem Fluid eines vorbestimmten Drucks derart dehnbar ist, daß der Durchmesser der Dichtungsvorrichtung im Bereich des Haftvermittlungselements vergrößerbar ist sowie einen Verbinder und ein Herstellungsverfahren.

IPC 8 full level
H01R 13/52 (2006.01); **H01R 13/504** (2006.01); **H01R 43/00** (2006.01)

CPC (source: EP)
H01R 13/5205 (2013.01); **H01R 13/504** (2013.01); **H01R 43/005** (2013.01)

Citation (search report)
• [A] EP 2161788 A1 20100310 - TYCO ELECTRONICS CORP [US]
• [A] US 2010075535 A1 20100325 - MIZUTANI TATSUHIKO [JP], et al
• [A] US 2011159729 A1 20110630 - SUZUKI SACHIO [JP], et al
• [A] US 5518415 A 19960521 - SANO TAKAHIRO [JP]
• [A] US 2012100737 A1 20120426 - FREY JEFFREY G [US]
• [A] JP H0594726 A 19930416 - YAZAKI CORP

Cited by
EP3252898B1

Designated contracting state (EPC)
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)
BA ME

DOCDB simple family (publication)
EP 2741375 A1 20140611; EP 2741375 B1 20160323; DE 102012024072 A1 20140612

DOCDB simple family (application)
EP 13005315 A 20131111; DE 102012024072 A 20121207